

2017年10月24日

各位

**FLEXCEEDとGE、ポリイミドフィルム基板を使った
次世代パッケージング・ソリューションの製品化に向け共同開発体制を構築**

FLEXCEED (フレクシード) 株式会社と GE ベンチャーズは、パワーオーバーレイ (POL)*1 と呼ばれる、ポリイミドフィルム基板を使ったパワーエレクトロニクス向け半導体部品内蔵型の次世代パッケージング・ソリューションに関して、FLEXCEED が特許ライセンスを 2017 年 2 月に取得したことを発表しました。この提携により、FLEXCEED と GE は次世代パッケージング・ソリューション開発と商品化の共同開発体制を構築します。詳細な商品化予定は後日発表いたします。

*1POL とは、ポリイミドフィルム基板に半導体 IC や電子部品を接着し、銅めっきで配線形成する「チップ・ファースト」パッケージング・ソリューション。従来の半導体モジュールと比較し、POL を使用すれば電気抵抗大幅低減、小型、薄型、高電気変換効率化が可能。

以上

報道関係お問い合わせ先

FLEXCEED 株式会社

経営企画部 國場 將生 (masao.kuniba@flexceed.co.jp)

電話 (029) 297-0771